

輝達 GTC 2026

GTC 2026 確認液冷、電源櫃、CPO 正向趨勢

FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index stock

焦點內容

1. 2026 年 Nvidia (美) GTC 大會關注重點，1) Vera Rubin (VR)設計與原先預期相符；2) 推出 LPX 機櫃；3) 2027-28 年 Kyber 機櫃；4) 展示 CPO 解決方案。
2. 凱基預估在新一代 Rubin 規格升級帶動下，均熱片、液冷、電源供應器、CCL/PCB 與交換機的內含價值都將上升。
3. 我們更正向看待散熱廠商，因 LPX 機櫃、HGX 伺服器液冷散熱設計增加，及電源廠，因 HVDC 電源櫃進展快於預期。
4. 我們預期 2026 年 GB300 AI 伺服器機櫃的出貨量將超過倍增，由 2025 年的大約 2.5 萬櫃大幅升至 6.5-7 萬櫃。2027 年 VR200 成為主流。
5. Nvidia 將推出全端 (Full-stack) 平台切入推論市場，包括 Vera CPU 機櫃、LPX 機櫃與數款代理型 AI 平台。我們看好推論需求增加將帶動 CPU 需求，並有利相關供應鏈業者業績。

重要訊息

Nvidia (美) 在 2026 年 GTC 大會上闡述 2026-28 年產品藍圖，揭露 Vera Rubin (VR) 與下一代平台 Vera Rubin Ultra & Feynman 的設計細節。GTC 展示了更多散熱與 HVDC 電源櫃的應用，可望為供應鏈挹注動能。

評論及分析

VR 機櫃設計符合預期。 Nvidia 揭露 VR 平台細節，大多符合預期。VR GPU 的熱設計功耗 (更高，將帶動零組件升級，而 VR compute tray 採模組化設計以縮短生產時間並提高組裝效率。Compute tray 內部採模組化 (6modules) 與無纜線設計，每層皆以液冷散熱。VR AI 世代數項零組件每層的內含價值較前一代將有所提升，包括均熱片成長三倍、電源供應器 (50-55%)、液冷 (以上，包含水冷板、內部歧管、快接頭 (PCB/CCL 與機櫃中板)。VR 機櫃沿用 Oberon 機櫃設計，每櫃搭載 72 個 VR GPU (即 144 個 GPU 晶粒、36 顆 Vera CPU 與 36 台 NVLink 6 交換機。網通端也升級至 800G/1.6T 交換機提高傳輸速度。凱基預期在 Rubin 世代規格升級帶動下，均熱片、液冷、電源供應、CCL/PCB 的內含價值都將上升。

發表 LPX 機櫃。 Nvidia 在 GTC 發表 Nvidia Groq 3 LPX 機櫃，是一款機櫃級推論加速器，滿足代理型 AI 系統對低延遲、大型上下文模型的需求。每顆 Groq 3 LPU 晶片 (LP30 晶片) 搭載 500MB SRAM 記憶體與 150TB/s SRAM 頻寬 LP30 採用 Samsung 4 奈米製程，預計 3Q26 開始出貨。LPU 晶片在 Vera Rubin Ultra 世代會升級為 LP35 晶片、Feynman 平台升級為 LP40 晶片。Nvidia Groq LPX compute tray 搭載八顆 LP30 晶片、一顆 CPU 目前為 x86 CPU)、一顆 Bluefield 4 DPU 或 ConnectX 9 NIC、一片 FPGA (含 fabric 擴展邏輯與

DRAM、32 條 LPU C2C 光纖連結。 LPX compute tray 採用無纜線、液冷設計，單層使用 11 片水冷板與 38 顆快接頭 (QD; 36+2 QD 使用量高於市場原預期之 26 顆，單層 TDP 11.1kW 有利 QD 業者富世達 (6805 TTD NT\$ 1,975, 增加持股。系統設計上，每櫃 LPX 機櫃配置 32 層 compute tray，共搭載 256 顆 LP30 晶片。LPX 機櫃將與 Vera Rubin NVL72 機櫃搭配，相較 Blackwell 系列，可處理的詞元 (token) 數最多提高 35 倍，兆級參數模型營收規模也可望提高 10 倍。該機櫃將採用液冷模組設計，並大量使用 52L M9 Q glass 基板 PCB，其液冷與 PCB 的內含價值皆高於 GB300 與 VR200。主要受惠者包括奇鋌 (3017 TTD NT\$ 2,015, 增加持股、BOYD 美、富世達、士電中與台光電 (2383 NT\$ 2,890 增加持股。202728 年 Kyber 機櫃設計。根據產品藍圖，Vera Rubin Ultra 平台將採用 Kyber 機櫃設計，由 36 台刀鋒伺服器與 12 台刀鋒交換機垂直旋轉排列組成，並透過中介板 (midplane) 互聯。每台運算刀鋒伺服器 (compute 搭載四顆 Rubin Ultra GPU 與兩顆 Vera CPU，而每台刀鋒交換機 (switch 配備六顆 NVLink 交換機晶片。因此，每一 Kyber NVL144 機櫃將配備 144 顆 GPU 與 72 顆 switch 晶片，2H27 有機會採用搭載 Rubin Ultra GPU。然而 Kyber 設計目前仍有數項工程瓶頸等待解決。Feynman 平台預計 2028 年上線，新晶片包括 Rosa CPU、Feynman GPU、LP40 LPU、Bluefield 5 DPU、NVLink 8CPO 晶片、Spectrum 7 CPO 晶片與 CX10 晶片。Feynman 平台將沿用 Kyber 機櫃設計除 Kyber NVL144 機櫃外，也可擴充至 Kyber NVL1152 機櫃，相較 Vera Rubin Ultra 僅有 NVL144 機櫃設計。

光纖與銅纜需求皆強，非替代關係。在市場關注 CPO 相關議題部分，本次 GTC 除了如我們先前報告中提及，Vera Rubin 平台相關之網通產品如 BlueField 4、NVLink6/NVLink7 交換器，CPO 解決方案之 Spectrum6 6 102T CPO 交換器，以及 ConnectX-9 SuperNIC 等。並另外揭示了將在 2028 年 Feynman 架構中引入 NVLink 8 CPO、並升級至下一代之 BlueField 5、ConnectX-10 SuperNIC 與 Spectrum-7 204T CPO 交換器，同時也表示隨未來將同時需要更多銅纜、光通訊與 CPO 產能，銅纜與光纖並非替代關係，而是需求皆持續提升。CEO Jensen 強調 2026-2027 年仍主要以櫃與櫃間 (scale out) 之交換器優先導入 CPO 解決方案，主要受害者為波若威 (3163 TT, NT\$918, 未評等)。

液冷散熱、與電源供應鏈展望更正向。VR 機櫃 compute tray 採無風扇設計且將使用更多水冷板，因此每台機櫃的液冷內含價值可望由 GB300 的 3.5-3.7 萬美元增加至 VR200 的 6.3-6.5 萬美元。未來 1.6T 交換機與 CPO 亦將採用液冷散熱。均溫板 (Heat spreader) 在 VR 平台的內含價值亦將成長 (詳細說明請參考《[Nvidia 2026 GTC 大會將底定 Vera Rubin 機櫃規格；CPO 趨勢備受矚目](#)》)。此外，LPX 機櫃將擴大整體散熱潛在市場規模，每一 LPX 機櫃的散熱內含價值將高於 GB 與 VR 系列機櫃。我們也注意到液冷散熱在 HGX 伺服器的滲透率在上升。相較於 Blackwell 世代採用氣冷散熱，Nvidia Rubin NVL8 的 CPU tray 改採液冷散熱，每層 CPU tray 配備五個水冷板模組，包括 CPU & DIMM (2 個模組)、交換機歧管 (2 個模組)、E1.S (1 個模組)，每層亦有 26 顆 QD (24+2)。HGX GPU tray 的液冷滲透率也將提高，每層 GPU tray 搭載八個水冷板模組、42 顆 QD (40+2)。液冷散熱滲透率上升有利於水冷板與 QD 供應商，如奇鋹、雙鴻 (3324 TT, NT\$1,070, 增加持股)、Cooler Master 與富世達。此外，電源供應器業者台達電 (2308 TT, NT\$1,455, 增加持股) 與光寶科 (2301 TT, NT\$160.5, 增加持股) 均在 GTC 大會上發表各自的 HVDC 電源機櫃設計。現場展示的 660kW HVDC 電源機櫃由 110kW 機架式電源與電池備援 (BBU) 電源組成，與±400/800V 的裝置相容。由於台達電與光寶科均表示 HVDC 電源機櫃出貨將於 2H26 啟動，由此推算 Nvidia 的伺服器機櫃將自 VR200 開始大規模採用 HVDC，步調上快於先前預期。凱基認為這項轉變意味著電源供應器在 VR200 的內含價值可能高於我們原先預估的 20 萬美元。因此，在出貨量與內含價值成長雙雙優於預期的情況下，我們更加看好散熱與電源供應族群的前景。

Nvidia 新平台 VR 及 VR ultra 導入 M9 材料與中介板 midplane，定穎及臻鼎則首度入供應鏈。我們預期 Nvidia Rubin 主運算板層數及材料規格持續提升，其中 Compute tray 維持 5 階 HDI，但層數由 22L 提升 26L，CCL 材料提升至 M8.5，CCL 仍以斗山 (韓) 為主，PCB 以勝宏 (中)、欣興 (3037 TT, NT\$581, 增加持股)、定穎 (3715 TT, NT\$190.5, 未評等)、臻鼎 (4958 TT, NT\$209.5, 增加持股) 為主。Switch tray 由 22L 提升至 32L，CCL 材料提升至 M8.5，以台光電及生益 (中) 為主，PCB 以滬士電、定穎為主。首度採用高層數中介板 midplane 設計連結 Compute tray PCB 以取代並整合傳輸線用於 Rubin (44L)、Rubin Ultra (78L 或 104L)。midplane、CPX (5 階 HDI, 22L)、LPU 晶片主板 (52L) 預期將採用 M9 材料 (Q-glass; 石英布) 材料，CCL 以台光電為主，PCB 為多家認證。

2026-27 年機櫃出貨量強勁成長，推論需求將顯著升溫。Nvidia 預期 2025-27 年 Blackwell 與 Rubin 系列產品的出貨總值將突破 1 兆美元。我們預期 2026 年 GB300 AI 伺服器機櫃的出貨量將超過倍增，由 2025 年的大約 2.5 萬櫃大幅升至 6.5-7 萬櫃。2027 年 VR200 將成為 AI 伺服器系統的硬體主流，屆時 R200 晶片的產量預料也將成長一倍以上至 400-500 萬顆，相較 2026 年 R200 晶片約 200 萬顆。隨著 GPU 與多項零組件升級，我們預期 AI 伺服器機櫃 (L11) ASP 將大幅提升：GB200 約為 300-350 萬美元、GB300 約為 400 萬美元，而 VR200 更可望提升至逾 600 萬美元，進一步推升 ODM 業者的 L11 組裝營收。除了超大型 CSP 的運算需求 (佔總量的 60%) 外，Nvidia 認為其餘 40% 需求存在龐大商機，將來自區域型雲端業者、工業、企業與主權。Nvidia 將推出全端 (Full-stack) 平台切入推論市場，包括 Vera CPU 機櫃、LPX 機櫃與數款代理型 AI 平台。為滿足與日俱增的代理型 AI 需求，Nvidia 推出 Vera CPU 機櫃，在單一液冷機櫃中整合最多 256 顆 Vera CPU，效率比傳統 x86 CPU 高出一倍，運算效率提升 50%。再加上 2026 年 CSP 業者對通用型伺服器的需求暢旺，我們看好推論需求增加將帶動 CPU 需求，並有利相關供應鏈業者業績，包括 CPU 插槽廠嘉澤 (3533 TT, NT\$2,030, 增加持股)、鴻騰精密 (FIT ; 港)，BMC 業者信驊 (5274 TT, NT\$12,050, 增加持股)，以及伺服器組裝廠緯穎 (6669 TT, NT\$3,765, 增加持股)。

投資建議

GTC 2026 將為整體 AI 供應鏈帶來更多正向動能，我們更正向看待散熱廠商 (因 LPX 機櫃、HGX 伺服器液冷散熱的設計增加)，以及電源廠，因 HVDC 電源櫃進展快於預期。其他受惠者包括 CCL/PCB 以及交換機。在 Rubin 新平台規格全面升級下，這些元件的內含價值將同步提高。新 AI 伺服器機櫃亦將帶動 CPO 交換機 (如 Quantum-X Photonics 與 Spectrum-X Photonics 交換機) 的滲透率上升。而 ODM 組裝廠也將因 L11 機櫃 ASP 提升而受惠，推動營收與獲利成長。各分類別的首選標的如下，液冷散熱: 奇鋐、富世達；均熱片: 健策；電源供應器: 台達電；CPO 相關: 上詮 (3363 TT, NT\$668, 未評等)、波若威、聯亞 (3081 TT, NT\$1,540, 增加持股)、光環 (3234 TT, NT\$93.5, 未評等)、華星光 (4979 TT, NT\$391.5, 增加持股)；PCB/CCL: 台光電、定穎投控、臻鼎；ODM 系統組裝: 鴻海 (2317 TT, NT\$205, 增加持股)、廣達 (2382 TT, NT\$286.5, 增加持股) 與緯創 (3231 TT, NT\$127.5, 增加持股)。

投資風險

CSP 之 AI 伺服器資本支出計畫放緩；生產或融資成本上升。

圖 1：NVIDIA 最新產品路線圖：Feynman 架構預計將在 2028 年推出



資料來源：NVIDIA GTC，凱基

圖 2：AI 工廠營收與成本效率提升的核心在於每瓦效能增長



資料來源：NVIDIA GTC; Semianalysis; InferenceX; 凱基

Nvidia Vera Rubin 平台

圖 3：Nvidia 推出 Vera Rubin 平台，包含 7 款晶片與 5 款機櫃系統

NVIDIA Vera Rubin 7 Chips – 5 Rack Systems AI Factory for the Agentic AI Frontier

1 GW AI Factory	X86 + Hopper	Vera Rubin
# of GPUs	600K	300K
AI FLOPS	1.2 ZFLOPS	16 ZFLOPS
All-to-All Scale-up	7.2 TB/s	260 TB/s
Memory BW-per-Domain (GROQ SRAM)	2 EB/s	100 EB/s
Tokens per Second	2M	700M

Rubin GPU

Vera CPU

CX9

BF4

NVLink Switch

Spectrum CPO

Groq 3 LPU

Vera Rubin Compute Tray

NVLink Switch Tray

Vera Compute Tray

BF4 STX Server

Spectrum Switch

Groq 3 Compute Tray

資料來源：NVIDIA GTC，凱基

圖 4：Nvidia 推出 VR POD，包含 GPU、CPU、LPX、SPX 與儲存櫃

NVIDIA
MGX NVL

NVIDIA
MGX ETL
Fully Configurable up to 256 chips

NVIDIA Vera Rubin NVL72
NVLink spine

NVIDIA Groq 3 LPX
Direct Chip-to-Chip spine

NVIDIA Vera CPU
Spectrum-X Ethernet spine

NVIDIA BlueField-4 STX Storage
Spectrum-X Ethernet spine

NVIDIA Spectrum-6 SPX

資料來源：NVIDIA，凱基

圖 5 : Nvidia Vera Rubin 機櫃設計



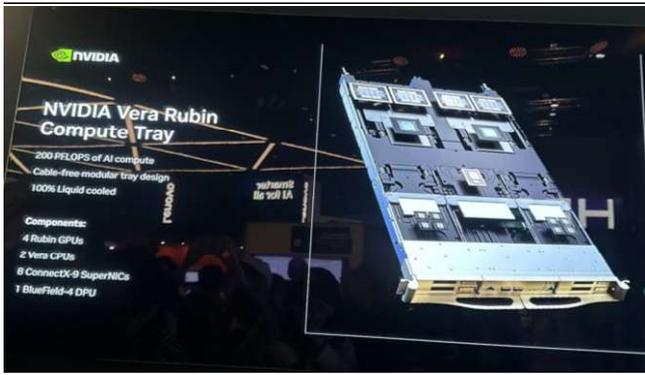
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 6 : Nvidia Vera Rubin 平台



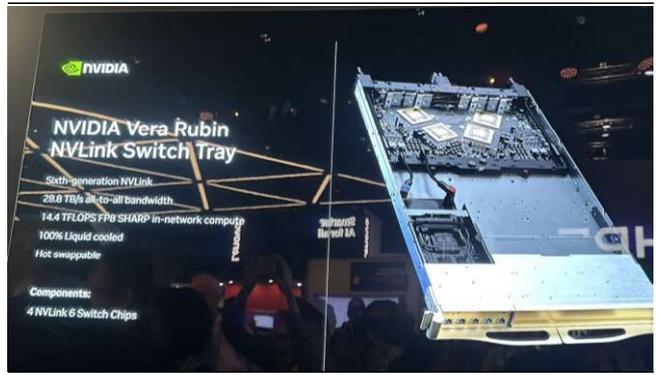
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 7 : Vera Rubin compute tray 採用模組化設計、無纜化與全液冷設計



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 8 : Vera Rubin switch tray 使用第六代 NVLink



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 9 : Nvidia Spectrum-X 乙太網路光通訊交換器



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

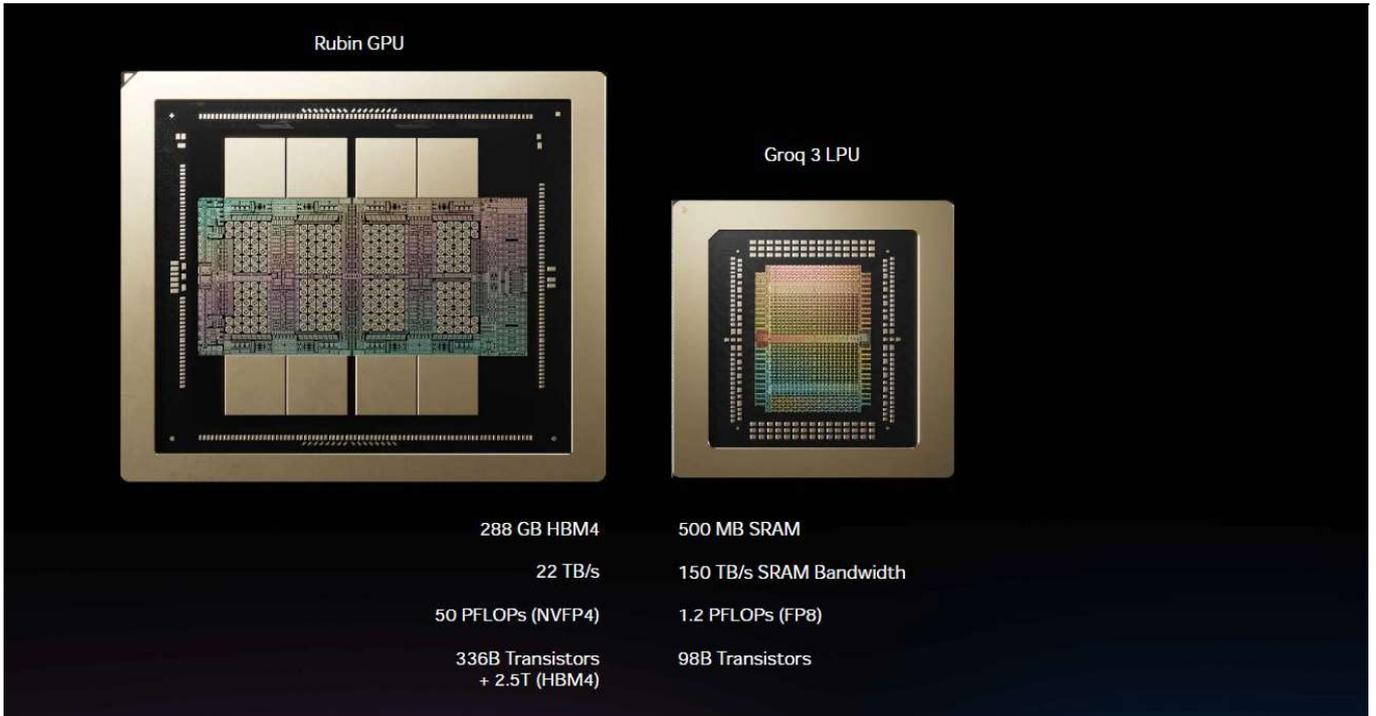
圖 10 : Nvidia Quantum-X InfiniBand 光通交換器



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

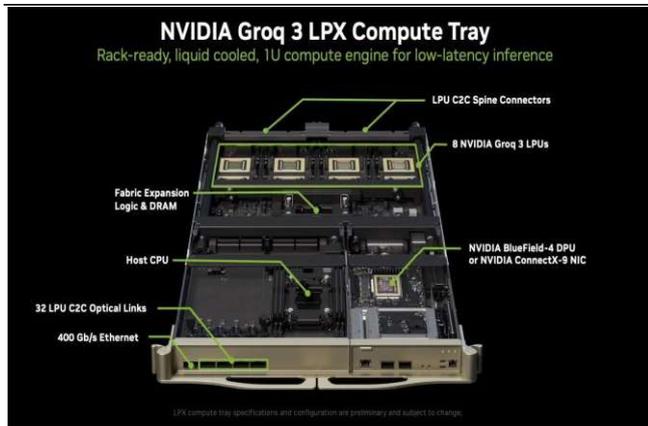
Nvidia Groq 3 LPX

圖 11：Groq 3 LPU 專為低延遲推論需求打造，晶片搭載 SRAM



資料來源：NVIDIA，凱基

圖 12：每層 Groq 3 LPX compute tray 搭載 8 顆 Nvidia Groq 3 LPU



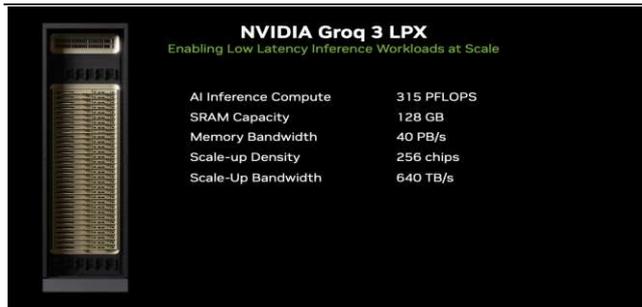
資料來源：NVIDIA，凱基

圖 13：Groq 3 LPX compute tray 使用 11 片水冷板模組與 38 顆快接頭 (36 顆 QD 加上 2 顆浮動快接頭)



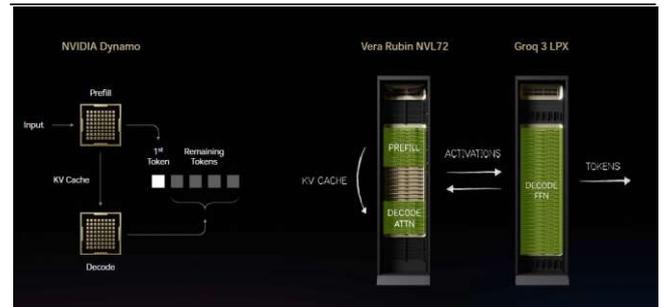
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 14：Nvidia 推出 Groq 3 LPX 機櫃



資料來源：NVIDIA GTC，凱基

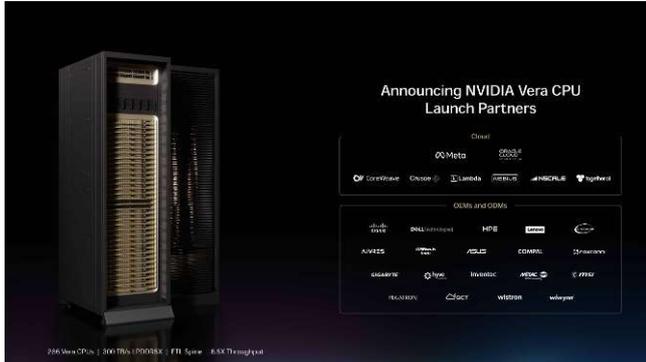
圖 15：Dynamo 協調異質運算資源



資料來源：NVIDIA GTC，凱基

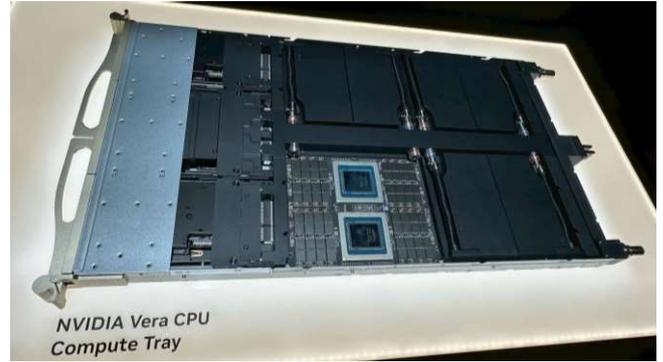
Vera CPU

圖 16 : Nvidia 發布 Vera CPU 機櫃，每櫃最高可支援 256 顆 Vera CPU，並採液冷設計



資料來源：NVIDIA GTC，凱基

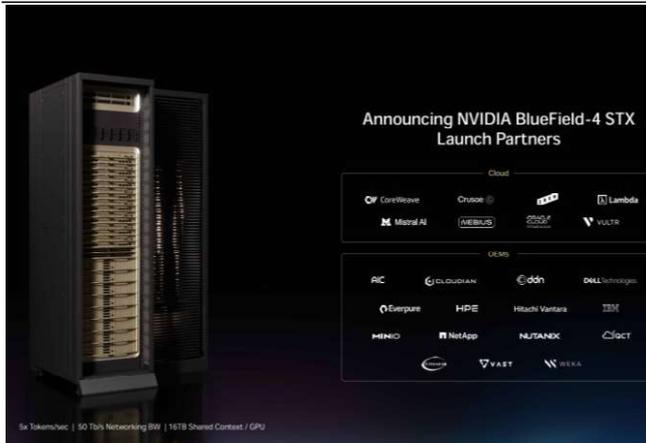
圖 17 : 每層 1U 設計的 Vera CPU compute tray 最多可支援 8 顆 CPU



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

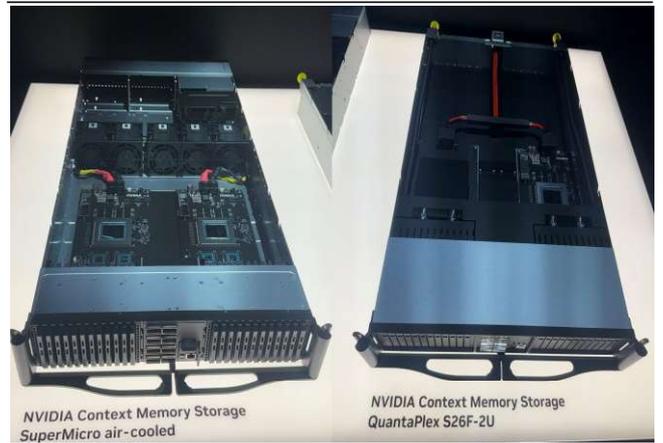
BlueField-4 STX

圖 18 : Nvidia 發布 BlueField-4 STX 機櫃



資料來源：NVIDIA GTC，凱基

圖 19 : 記憶體存儲 tray 採液冷與氣冷兩種設計



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

Nvidia Vera Rubin NVL8 平台

圖 20 : NVIDIA HGX Rublin NVL8 CPU tray



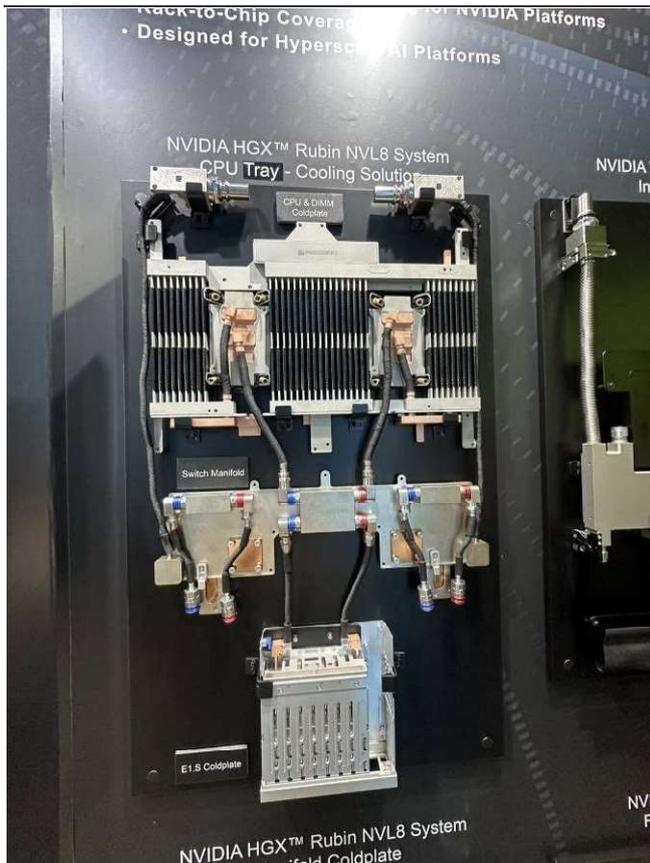
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 21 : NVIDIA HGX Rublin NVL8 GPU tray 搭載八顆 NVIDIA Rublin GPU



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 22：每層 HGX Rubin NVL8 CPU tray 使用 5 個水冷板模組



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 23：Nvidia VR NVL8 系統每層 GPU tray 使用 8 個水冷板模組以及 42 個快接頭 (40+2)



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

電源解決方案

圖 24：Vera Rubin NVL72 系統的 110kW power shelf



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

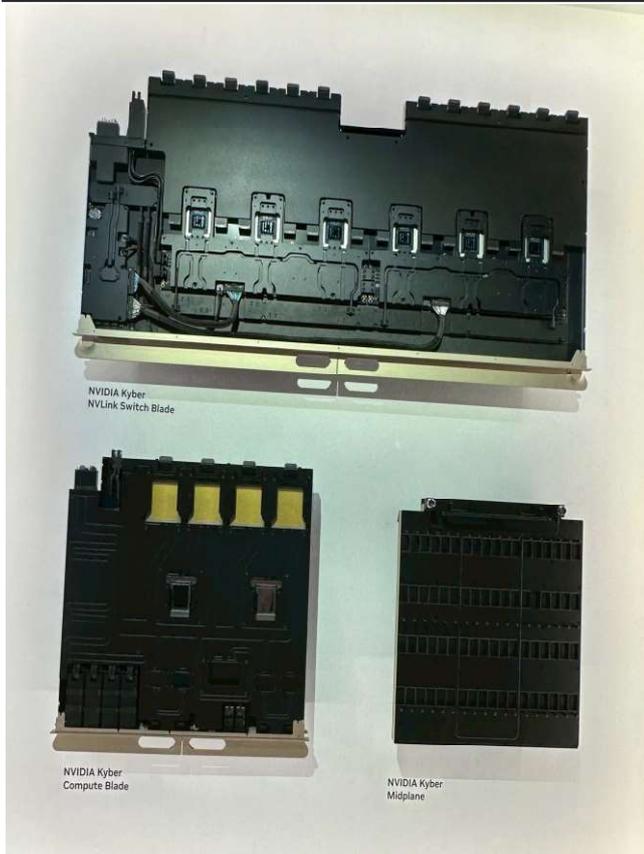
圖 25：台達電展示 800V 直流電 (800VDC) 電源櫃解決方案



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

Nvidia Kyber 架構

圖 26 : Nvidia 展示 Kyber 架構，將系統設計從托盤式 (tray-based) 轉向刀鋒式 (blade-based)



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 27 : Nvidia Kyber 整機櫃設計



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

Nvidia MGX ETL 機櫃

圖 28 : Vera Rubin MGX ETL，將 MGX 從僅支援 scale-up NVL 機櫃，擴展到支援低延遲推論與高 KV-cache 的工作負載

MGX NVL Rack

Front Back

MGX ETL Rack

Front Back

Compute Trays
HGX, RTX, XPU, etc.

Switch Trays
Spectrum-X
Ethernet

Spine
Spectrum-X
Ethernet

One Rack-Scale Ecosystem

80+

MGX Ecosystem Partners

MGX Rack	Bracketry	Power Whip
Power Shelf	Cold Plate	Cable Cartridge
Rack Manifold	Chassis	UQD & MQD
Slide Rail	Busbar	CDU

...

資料來源：NVIDIA，凱基

圖 29：Vera Rubin 平台在 GTC 設計定案，Vera Rubin 晶片效能較前代提升，機櫃設計延續 Oberon (一櫃 72 GPU)

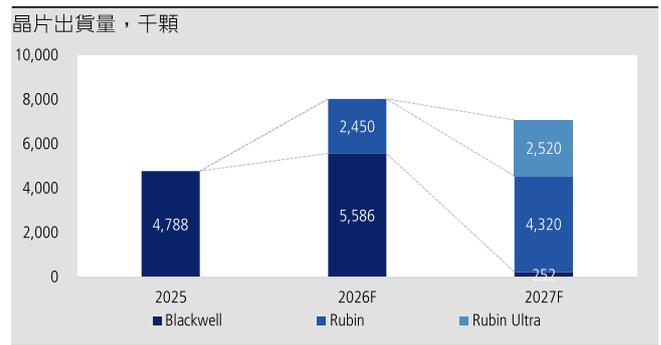
	B300/GB300 (Ultra)	Rubin NVL8 HGX	Vera Rubin NVL72	Rubin Ultra NVL144
晶片與封裝層級				
GPU TDP (W)	1,100/1,400		2,300	3,000+
製程節點	4NP		N3P (3NP)	N3P (3NP)
邏輯晶粒參數	兩倍光罩尺寸GPU		兩倍光罩尺寸GPU, 2x I/O小晶片	四倍光罩尺寸GPU, 4x I/O小晶片
FP8 PFLOPs -Dense (per package)	5	17.5	17.5	35
FP16 PEFLOPs -Dense (per package)	2.5	4	4	8
記憶體	288GB HBM3E		288GB HBM4	1,024GB HBM4E
HBM層數	8		8	16
記憶體頻寬	8TB/s		22TB/s	53TB/s
封裝	CoWoS-L		CoWoS-L	CoWoS-L
Nvidia CPU	Grace	N.A.	Vera	Vera
System Form Factor				
最高系統密度	NVL72 144運算小晶片 72邏輯GPU	NVL8 16運算小晶片 8邏輯GPU	NVL72 144運算小晶片 72邏輯GPU	NVL144 576運算小晶片 144邏輯GPU
結構標準	HGX/Oberon	HGX	Oberon	Kyber
GPU封裝數	72	8	72	144
GPU晶粒數	144	16	144	576
Scale-up連接	銅背板	UBB (PCB)	銅背板	PCB背板

資料來源：公司資料、Bloomberg、凱基

圖 30：2026 年 Nvidia 晶片出貨量將上升

晶片出貨量(千顆)		2024	2025F	2026F	2027F
ASIC	Google	2,099	2,527	4,312	7,680
	AWS	1,225	1,600	2,428	3,360
	Meta	300	350	400	650
	Microsoft	60	60	200	400
GPU	NVIDIA	3,838	5,310	8,239	7,092
	AMD	490	627	655	1,060
YoY(%)		2024	2025F	2026F	2027F
ASIC	Google		20	71	78
	AWS		31	52	38
	Meta		17	14	63
	Microsoft		0	233	100
GPU	NVIDIA		38	55	(14)
	AMD		28	4	62

資料來源：凱基預估

圖 31：因 HBM4 出貨遞延，2026 年 AI 晶片產能仍將以 Blackwell GPU 為多


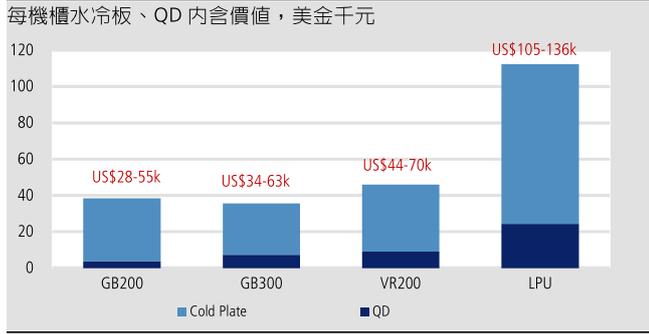
資料來源：凱基預估

圖 32：GB300 與 VR200 機櫃液冷內含價值持續提升

		GB200	GB300	VR200	LPU
水冷板用量(每櫃)	Compute tray	108	108	198	
	Switch tray	18	27	36	352
	總計	126	135	234	352
QD用量(每櫃)	Compute tray	180	180	396	
	Switch tray	0	180	54	1,216
	總計	180	360	450	1,216
(美元)		GB200	GB300	VR200	LPU
Compute tray 水冷板單價		280	200	150	
Switch tray 水冷板單價		250	250	200	250
QD單價		20	20	20	20
Compute tray內分歧管單價				1,000	
(US\$)		GB200	GB300	VR200	LPU
內含價值(每櫃)	水冷板	34,740	28,350	36,900	88,000
	QD	3,600	7,200	9,000	24,320
	內分歧管			18,000	
	總計	38,340	35,550	63,900	112,320

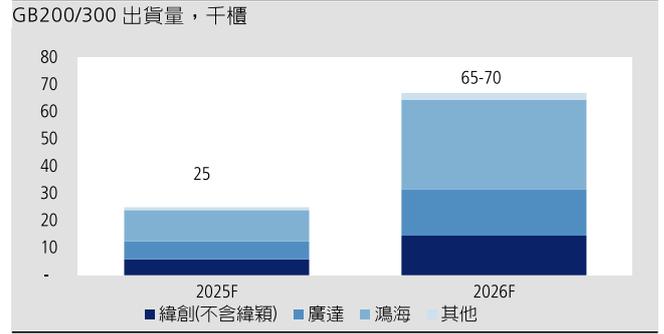
資料來源：公司資料、凱基預估

圖 33：LPU 機櫃液冷散熱的內含價值高於 GB300 與 VR200 機櫃



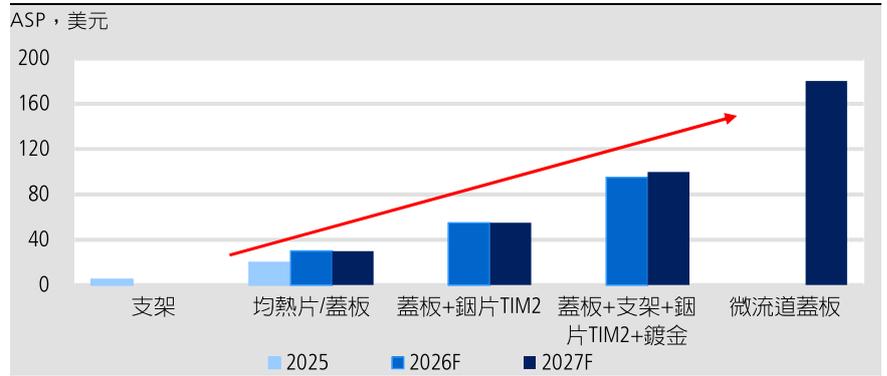
資料來源：公司資料；凱基預估

圖 34：2025 年 GB200/300 出貨量達約 2.5 萬櫃，預估 2026 年出貨量 6.5-7 萬櫃



資料來源：公司資料；凱基預估

圖 35：Heat spreader / lid/ 金屬 TIM / MCL 各項產品價格趨勢皆持續上揚



資料來源：公司資料；凱基預估

圖 36：雲端同業評價比較

領域	公司	代碼	市值 (美金 百萬元)	股價 (當地 貨幣)	評等	目標價 (元)	每股盈餘 (當地貨幣)			每股盈餘 年增率 (%)			PE (x)			PB (x)			ROE (%)			現金殖利率 (%)	
							2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F
ODM	鴻海精密	2317 TT	90,010	205.00	增加持股	340.0	14.68	18.90	25.20	33.4	28.8	33.3	14.0	10.8	8.1	1.6	1.5	1.4	12.0	14.6	18.0	2.8	3.8
	英業達	2356 TT	4,901	43.45	持有	47.0	2.42	2.94	3.96	19.7	21.4	34.7	17.9	14.8	11.0	2.1	2.1	2.0	12.1	14.5	18.9	3.9	4.6
	廣達	2382 TT	34,796	286.50	增加持股	405.0	19.45	22.49	28.21	25.6	15.6	25.4	14.7	12.7	10.2	4.7	4.4	4.0	32.7	35.3	41.0	4.5	5.4
	緯創	3231 TT	12,750	127.50	增加持股	220.0	9.04	13.60	18.17	47.9	50.4	33.6	14.1	9.4	7.0	2.3	1.9	1.6	17.7	21.4	24.3	3.0	4.3
	緯穎	6669 TT	22,000	3,765	增加持股	6180.0	275.06	314.28	410.57	117.3	14.3	30.6	13.7	12.0	9.2	5.6	4.6	3.8	48.0	42.4	45.4	2.0	3.9
	技嘉	2376 TT	5,226	248	增加持股	310.0	18.20	22.16	26.04	21.1	21.8	17.5	12.5	10.3	8.8	2.7	2.8	2.6	22.2	25.8	28.7	4.7	6.4
	華碩	2357 TT	13,499	578	增加持股	615.0	59.99	43.90	51.48	41.9	(26.8)	17.3	9.6	13.2	11.2	1.6	1.6	1.5	16.6	12.0	13.6	5.9	7.3
	華擎	3515 TT	855	220	增加持股	290.0	15.28	20.70	24.89	45.0	35.5	20.3	14.4	10.6	8.8	2.3	2.1	1.9	17.7	20.5	22.6	2.4	5.0
插槽/ 連接器/ 連接線	嘉澤	3533 TT	7,183	2,030.00	增加持股	2200.0	70.17	97.73	122.25	(15.2)	39.3	25.1	28.9	20.8	16.6	5.7	5.0	4.4	20.7	25.7	28.0	2.0	1.7
	貿聯-KY	3665 TT	10,544	1,720.00	增加持股	2220.0	46.57	71.23	91.57	83.3	53.0	28.5	36.9	24.1	18.8	7.2	5.8	4.7	21.7	26.6	27.8	0.7	0.9
	宏致	3605 TT	318	62.10	受法規限制	N.A.	4.28	5.47	N.A.	70.1	28.0	N.A.	14.5	11.3	N.A.	1.3	1.2	N.A.	9.6	11.6	N.A.	1.2	2.1
	優群科技*	3217 TT	449	158.50	未評等	N.A.	12.63	13.63	N.M.	12.3	7.9	N.A.	12.5	11.6	N.A.	3.0	2.0	N.A.	24.3	26.3	N.M.	5.6	6.1
導軌	凡甲科技	3526 TT	611	296.00	增加持股	325.0	16.97	21.05	26.05	1.0	24.0	23.7	17.4	14.1	11.4	5.0	5.0	4.9	29.0	36.0	44.4	5.6	5.7
	川湖	2059 TT	10,712	3,575.00	增加持股	5100.0	103.23	151.79	188.21	59.8	47.0	24.0	34.6	23.6	19.0	12.2	9.5	7.5	39.9	45.4	44.3	0.9	1.4
散熱模組	建準	2421 TT	1,249	144.50	增加持股	200.0	8.09	11.79	N.A.	48.2	45.8	N.A.	17.9	12.3	N.A.	4.6	4.2	N.A.	26.8	35.7	N.A.	2.6	4.0
	雙鴻	3324 TT	3,131	1,070.00	增加持股	1255.0	30.41	54.15	77.16	43.2	78.1	42.5	35.2	19.8	13.9	9.4	7.5	5.9	28.5	42.3	47.5	0.9	1.3
	奇鋐	3017 TT	24,754	2,015.00	增加持股	2600.0	49.17	89.08	127.38	131.8	81.2	43.0	41.0	22.6	15.8	18.0	12.5	8.6	52.2	63.7	63.2	0.5	1.0
	高力*	8996 TT	2,765	951.00	增加持股	1140.0	9.07	21.04	29.67	38.2	132.1	41.0	104.9	43.6	32.1	21.0	14.5	11.5	21.9	39.1	41.0	0.4	0.5
均熱片	健策	3653 TT	17,765	3,900.00	增加持股	4200.0	36.75	59.05	120.00	52.2	60.7	103.2	106.1	66.0	32.5	25.1	21.8	17.3	28.3	34.6	58.2	0.4	0.6
BBU	新普	6121 TT	2,038	350.50	增加持股	430.0	30.60	30.74	32.47	6.0	0.5	5.6	11.5	11.4	10.8	1.7	1.6	1.6	15.1	14.5	14.7	5.8	6.2
	AES-KY	6781 TT	2,686	1,000.00	增加持股	1455.0	38.20	47.97	68.45	50.4	25.6	42.7	26.2	20.8	14.6	5.2	4.6	4.0	21.0	23.6	29.4	1.3	1.9
機殼	勤誠	8210 TT	3,515	892.00	增加持股	1290.0	29.06	45.75	57.45	81.1	57.4	25.6	30.7	19.5	15.5	10.3	8.1	6.5	39.4	46.2	46.0	0.8	1.6
BMC	信懋科技*	5274 TT	14,323	12,050	增加持股	10500.0	100.98	157.46	209.98	48.4	55.9	33.4	119.3	76.5	57.4	61.1	43.4	32.7	58.3	66.3	65.0	0.4	0.6
矽光	聯亞	3081 TT	4,480	1,540.00	增加持股	1080.0	4.63	13.12	21.43	N.M.	183.3	63.4	332.6	117.4	71.9	36.3	40.0	38.1	11.1	34.8	54.3	0.0	0.2
CCL	聯茂*	6213 TT	1,731	151.50	增加持股	152.0	4.16	6.94	9.88	83.8	66.8	42.4	36.4	21.8	15.3	2.6	2.4	2.2	7.2	11.4	15.2	1.2	2.0
ABF	光光電子	2383 TT	32,560	2,890.00	增加持股	2985.0	40.97	66.11	99.49	47.3	61.3	50.5	70.5	43.7	29.0	20.5	15.9	12.0	34.9	42.4	48.7	0.6	0.9
	欣興電子	3037 TT	28,782	581.00	增加持股	560.0	4.36	13.54	23.78	30.6	210.4	75.6	133.2	42.9	24.4	8.9	7.6	6.1	6.9	19.1	27.8	0.3	0.3
PCB	金像電	2368 TT	16,133	1,005.00	增加持股	1100.0	19.02	32.82	45.84	64.8	72.5	39.7	52.8	30.6	21.9	16.5	11.9	8.8	37.4	46.4	47.4	0.6	1.0
電源供應	台達電	2308 TT	118,835	1,455.00	增加持股	1770.0	23.14	36.42	55.30	70.6	57.4	51.9	62.9	40.0	26.3	14.1	11.4	8.8	24.1	31.5	37.8	0.5	0.8
	光寶科	2301 TT	11,692	160.50	增加持股	216.0	6.64	8.27	11.33	27.5	24.5	37.0	24.2	19.4	14.2	4.1	3.8	3.3	16.7	20.2	24.9	2.8	3.1
	群電*	6412 TT	993	78.80	未評等	N.A.	5.41	6.06	7.96	(35.2)	12.1	31.4	14.6	13.0	9.9	2.5	1.9	1.9	15.5	15.4	20.3	7.6	7.6
	康舒*	6282 TT	1,346	50.00	未評等	N.A.	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0	N.A.
晶圓代工	台積電	2330 TT	1,508,463	1,850.00	增加持股	2420.0	66.25	95.71	118.01	46.4	44.5	23.3	27.9	19.3	15.7	9.0	6.6	4.9	35.7	39.4	35.8	0.9	1.1
設計服務	世心-KY	3661 TT	8,235	3,220.00	增加持股	4590.0	66.39	127.76	168.28	(18.4)	92.4	31.7	48.5	25.2	19.1	6.7	5.6	4.7	13.7	24.1	26.7	1.2	1.0
	創意	3443 TT	10,998	2,610.00	增加持股	3680.0	28.13	48.98	81.56	9.2	74.1	66.5	92.8	53.3	32.0	27.2	20.9	15.2	31.2	44.3	55.0	0.6	0.8
網通	華星光	4979 TT	1,736	391.50	增加持股	250.0	5.40	9.94	N.A.	42.6	84.2	N.A.	72.5	39.4	N.A.	13.9	10.4	N.A.	20.1	28.8	N.A.	0.4	0.6
	智邦	2345 TT	28,052	1,590.00	增加持股	1850.0	47.13	61.74	N.A.	119.3	31.0	N.A.	33.7	25.8	N.A.	16.4	12.7	N.A.	58.1	55.6	N.A.	0.8	0.9

* Bloomberg 共識預估

資料來源：Bloomberg；凱基預估

上述凱基分析員為證監會持牌人，隸屬凱基證券亞洲有限公司從事相關受規管活動，其及 / 或其有聯繫者並無擁有上述有關建議股份，發行人及 / 或新上市申請人之財務權益。

免責聲明 於本報告內所載的所有資料，並不擬提供予置身或居住於任何法律上限制凱基證券亞洲有限公司（「凱基」）或其關聯成員派發此等資料之司法管轄區的人士或實體使用。此等資料不構成任何司法管轄區的任何人士或實體作出的任何投資意見、或發售的要約、或認購或投資任何證券或其他投資產品或服務的邀請、招攬或建議，亦不構成於任何司法管轄區用作任何上述的目的之資料派發。請特別留意，本報告所載的資料，不得在美國、或向美國人士（即美國居民或按照美國或其任何州、屬土或領土之法律成立的合夥企業或公司）或為美國人士之利益，而用作派發資料、發售或邀請認購任何證券。於本報告內的所有資料只作一般資料及參考用途，而沒有考慮到任何投資者的特定目的、財務狀況或需要。該等資料不擬提供作法律、財務、稅務或其他專業意見，因此不應將該等資料賴以為投資專業意見。

部份凱基股票研究報告及盈利預測可透過 www.kgi.com.hk 取閱。詳情請聯絡凱基客戶服務代表。本報告的資料及意見乃源於凱基的內部研究活動。本報告內的資料及意見，凱基不會就其公正性、準確性、完整性及正確性作出任何申述或保證。本報告所載的資料及意見如有任何更改，凱基並不另行通知。凱基概不就因任何使用本報告或其內容而產生的任何損失承擔任何責任。本報告亦不存有招攬或邀約購買或出售證券及 / 或參與任何投資活動的意圖。本報告只供備閱，並不能在未經凱基書面同意下，擅自以任何方式轉發、複印或發佈全部或部份內容。凱基集團成員公司或其關聯人可提供服務予本文所提及之任何公司及該等公司之關聯人。凱基集團成員公司、其關聯人及其董事、高級人員及僱員可不時就本報告所涉及的任何證券持有。